



三井金属

2023年12月12日

各 位

パッケージ基板用キャリア付極薄銅箔の生産体制を增強

～ 上尾事業所の生産能力を月産 250 万㎡へ ～

当社（社長 納武士）は、パッケージ基板用キャリア付極薄銅箔について、上尾事業所（埼玉県上尾市）の生産能力を 50 万㎡増強し月産 250 万㎡としたことをご知らせいたします。

当社のキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」は、微細回路形成に適した 1.5 μm～5 μm の銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせた製品であり、主にパッケージ基板、スマートフォン用マザーボード（HDI プリント基板）に使用されております。

パッケージ基板用「MicroThin™」は、スマートフォンでは 5G 対応などの高機能化に伴い採用される搭載部品が増加しており、またスマートフォン以外でもデータセンターや車載向けメモリー基板用途等の採用拡大により需要が伸長していくものと考えております。

そのため、マザー工場である上尾事業所において、働きがい改革による従業員のエンゲージメント向上による労働生産性の改善を図るとともに、DX 導入による製造データの収集と解析による稼働率や歩留まり等の技術係数の改善により、大きな設備投資をすることなく、生産能力を月産 200 万㎡から 250 万㎡へと大幅な增強を実現いたしました。

これにより、現在のマレーシア工場(Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.)の「MicroThin™」生産能力である月産 240 万㎡と合わせた当社トータルの生産能力は、月産 440 万㎡から月産 490 万㎡となり需要増に対して十分対応可能な体制が整いました。また、今後、需要の増加状況に合わせて上尾事業所での取組みをマレーシア工場へ展開することも検討していきます。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030 年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で “未来” に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献します。

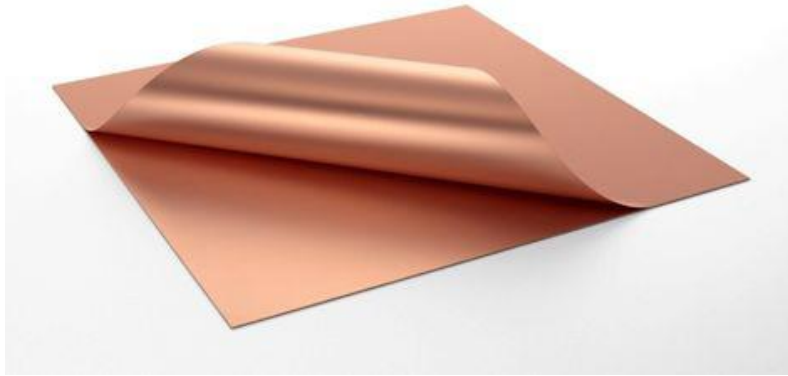
以上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 Eメール : PR@mitsui-kinzoku.com

「MicroThin™」写真



上部：キャリア銅箔（厚み 18 μ m、12 μ m）

下部：極薄銅箔（厚み 1.5 μ m～5 μ m）